导电银胶 KXS20E

产品简介

- 导电银胶KXS20E是是一种单组分、无溶剂导电银胶，该结构胶具有较高的导热粘接性能。适用于多基材的导电粘结，广泛应用于集成电路元器件的粘结与封装。该导电胶施胶操作方便，可调控性高，体积电阻率低，导热性高。

典型性能

- 施工性能优异
- 高导热率
- 低电阻率

联系我们：
蒋丹萍152-6144-8356；张艳138-5168-3378；荣岩180-6607-5325；
田晓冰152-5095-2541；许飞艳132-7663-5250；杨慧子159-9624-3638

	测试项目	KXS20E	
固化前	外观	银色	目视
	粘度（25℃，cp）	23000±5000mPa•s	ASTM D 2196
	适用时间（25℃）	7天	-
	固化时间(150℃)	1h	-
	建议储存条件	@-5~-20 ℃ 6个月	-
固化后	硬度 shore D	85	GB/T 2411-2008
	导热系数 W/(m·k)	≥1.6	Laser Flash
	体积电阻率 Ω.cm	7×10^{-4} Ω.cm	GB/T 1410-2006
	剪切强度 MPa（Al/Al）	≥12	GB/T 7124-2008
	0.3mmSi 芯片 Ag/Cu基板@25℃	≥10 N	MIL-STD-883
	2mmSi芯片 Ag/Cu基板@25℃	≥100 N	
	玻璃化转变温度Tg	103℃	GB/T 19466.2
	CTE（Tg前）	55 ppm/℃	
	CTE（Tg后）	167 ppm/℃	
	耐温范围 ℃	-50～200	-

使用方法：

- 打开包装之前，确保包装完整、无破损、产品在使用期内。
- 从冰箱取出后，在解冻时将注射器垂直放置；回温至25℃，开封前务必清除水汽。
- 已使用的产品不可倒入未使用的原包装产品中，避免污染；解冻后的产品避免重新冻结。
- 建议使用本资料中推荐的固化工艺进行固化。

包装、储存与运输：

- 塑料管包装，3CC、5CC、10CC、30CC支装；
- 避免挤压、碰撞或硬划伤，防止高温、雨淋或阳光直射；
- 此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

注意事项：

- 对于高强度的结构粘接，去除表面的污染物，如油漆，氧化膜，油、灰尘，脱模剂和所有其他表面污染物；
- 为获得更大的粘接强度，推荐双面涂胶；
- 固化过程中采用适当夹具并且保证不要产生粘接部件之间的相对位移，固化前清楚多余的余胶；
- 本品不可与强氧化剂类物质接触，应存放在儿童接触不到的地方；
- 本品对眼睛有刺激性，可能引起皮肤过敏，使用时请做好防护措施；如有不慎接触眼睛和皮肤，立即清水清洗，必要时，请立即就医。